

Descrizione del prodotto

FINITURA: QUESTO BOARD SARÀ IMMERSIONE OGGETTO SECONDO IPC-6012.
LA SPESSORE SARA .050UM SUI NICKEL 3-6uM.

LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI

Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del livello

L1 ----- HOZ

- PP 7mil -

--

L2 ----- 1OZ

- CORE 9.05mil -

L3 ----- 1OZ

--

- PP 7mil -

L4 ----- HOZ

Definizioni del livello:

* .GCMT - Top maschera di rivestimento convenzionale

* .GTP - Top Paste saldanti

* .GTO - Top Silkscreen

* .GTS - Top Soldermask

* .GTL - Top Layer

* .G2L - Livello segnale interno 1

=====

* .G3L - Livello segnale interno 2

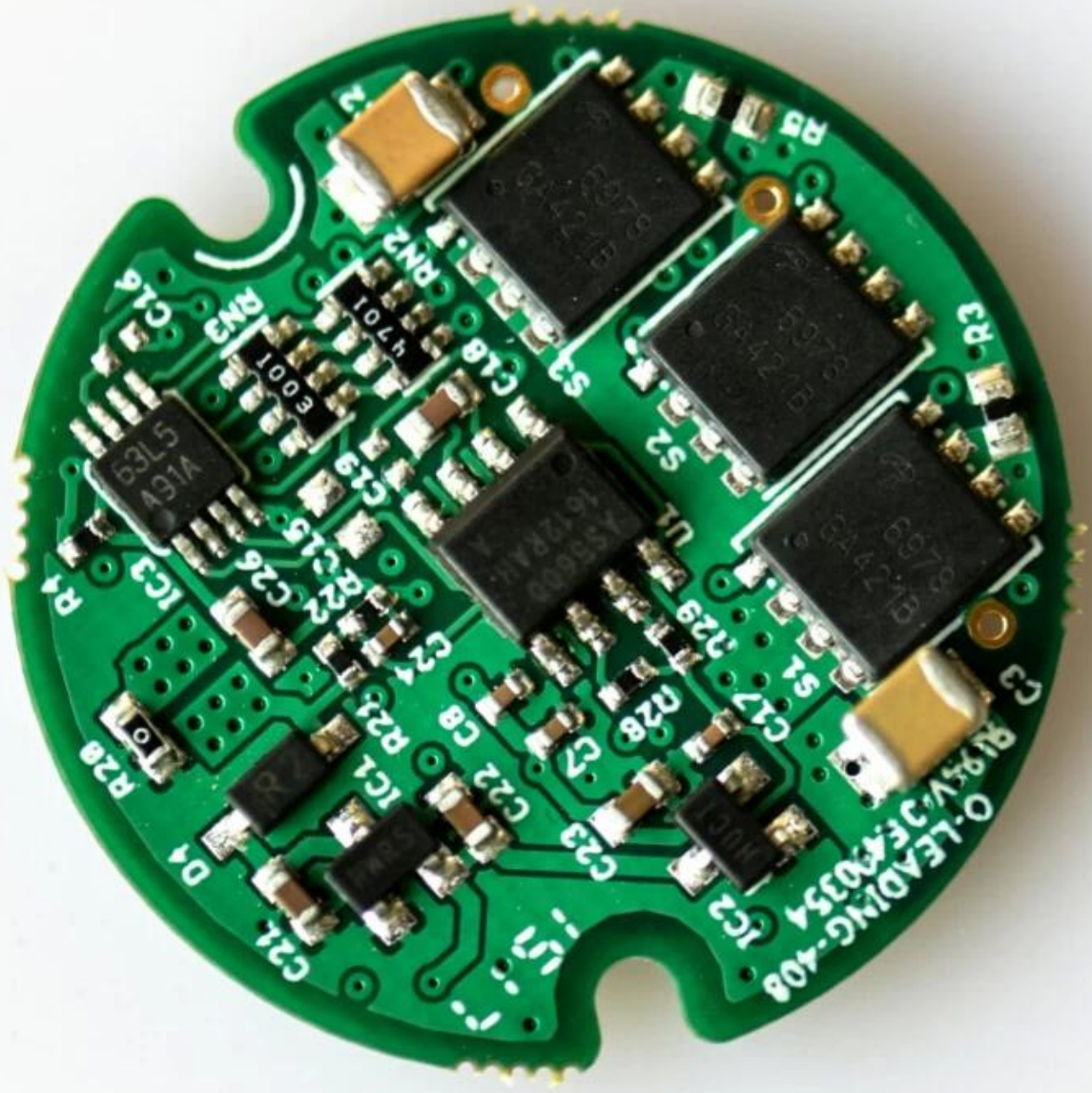
* .GBL - Livello inferiore

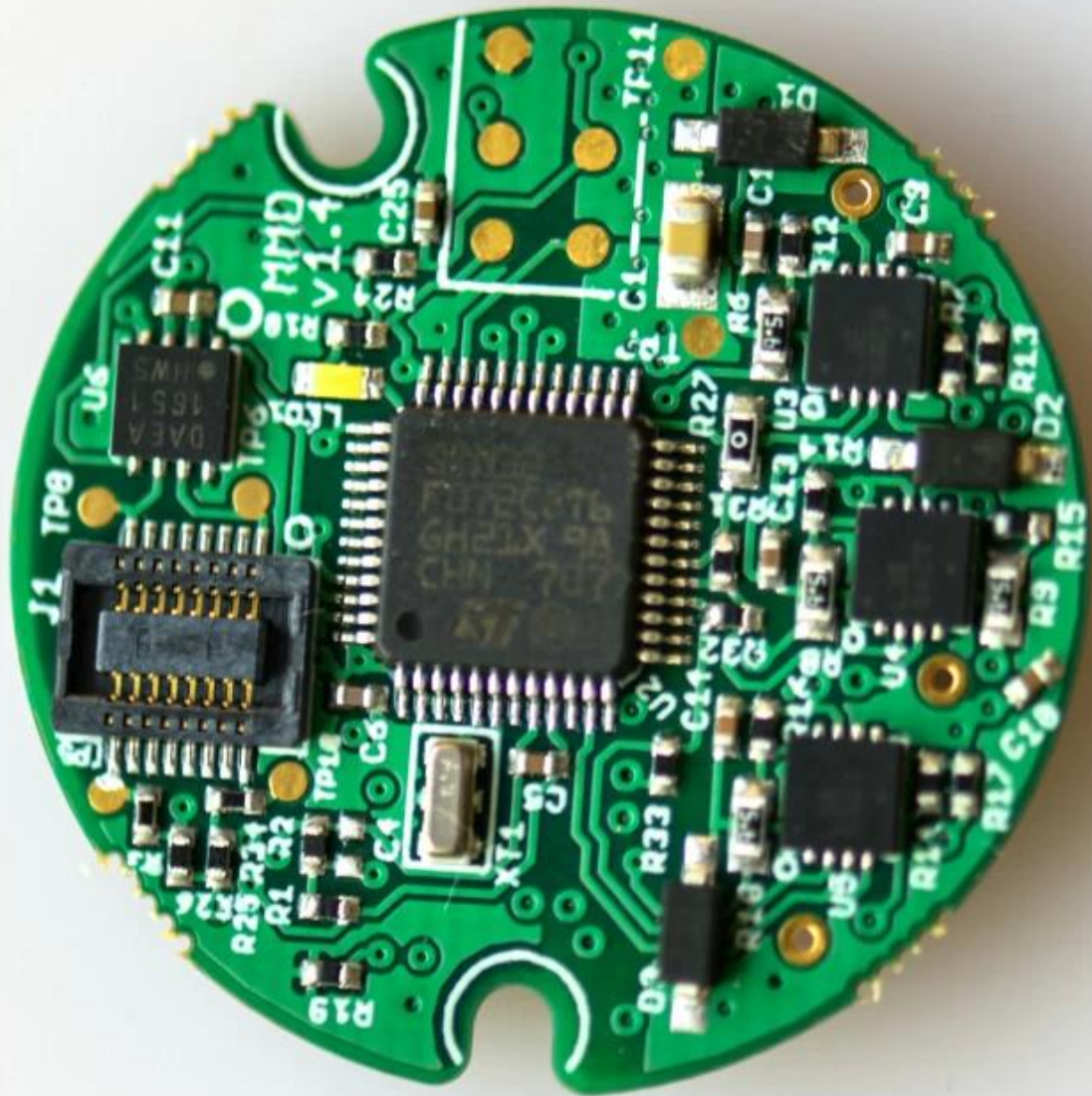
* .GBS - Bottom Soldermask

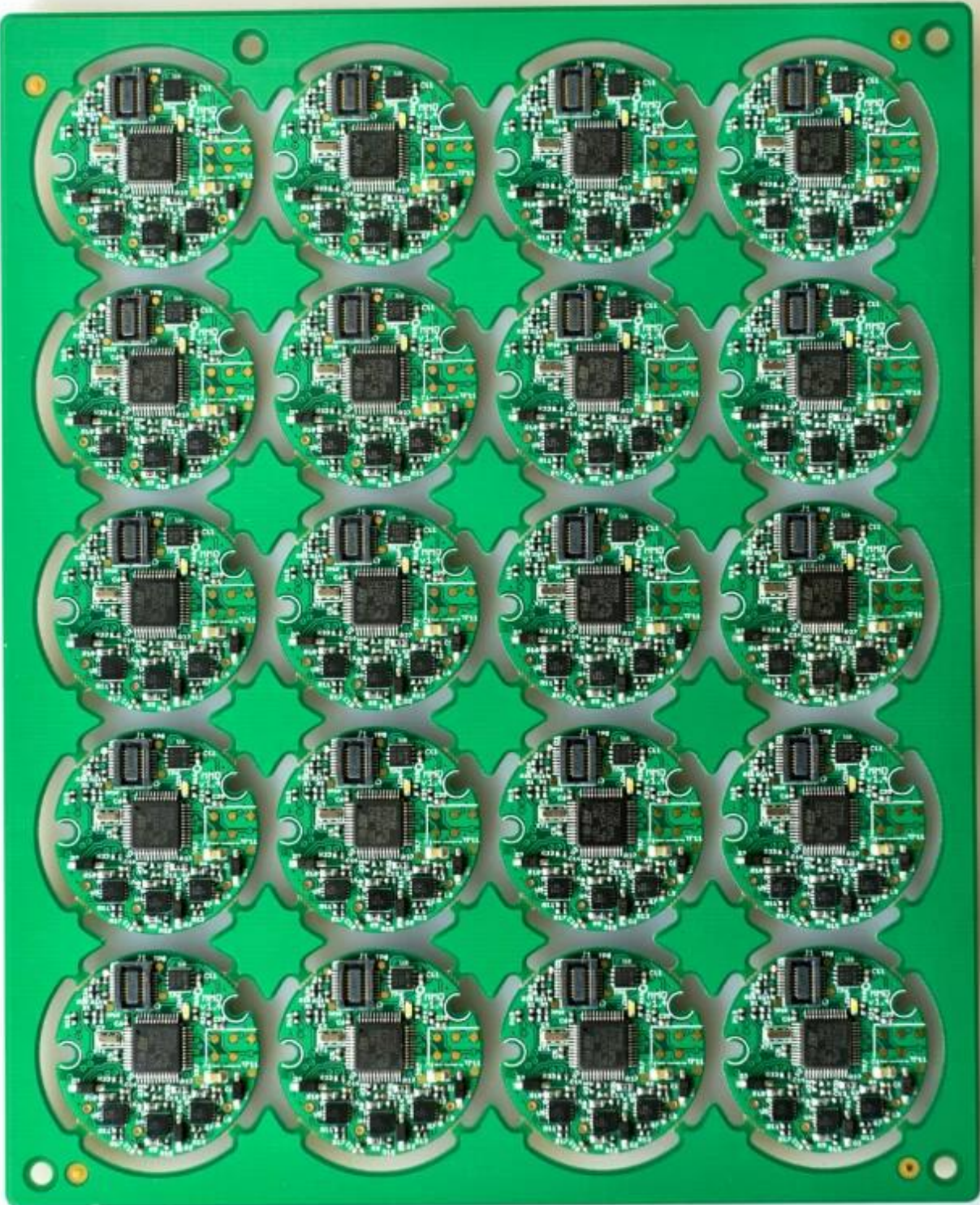
* .GBO - Silkscreen inferiore

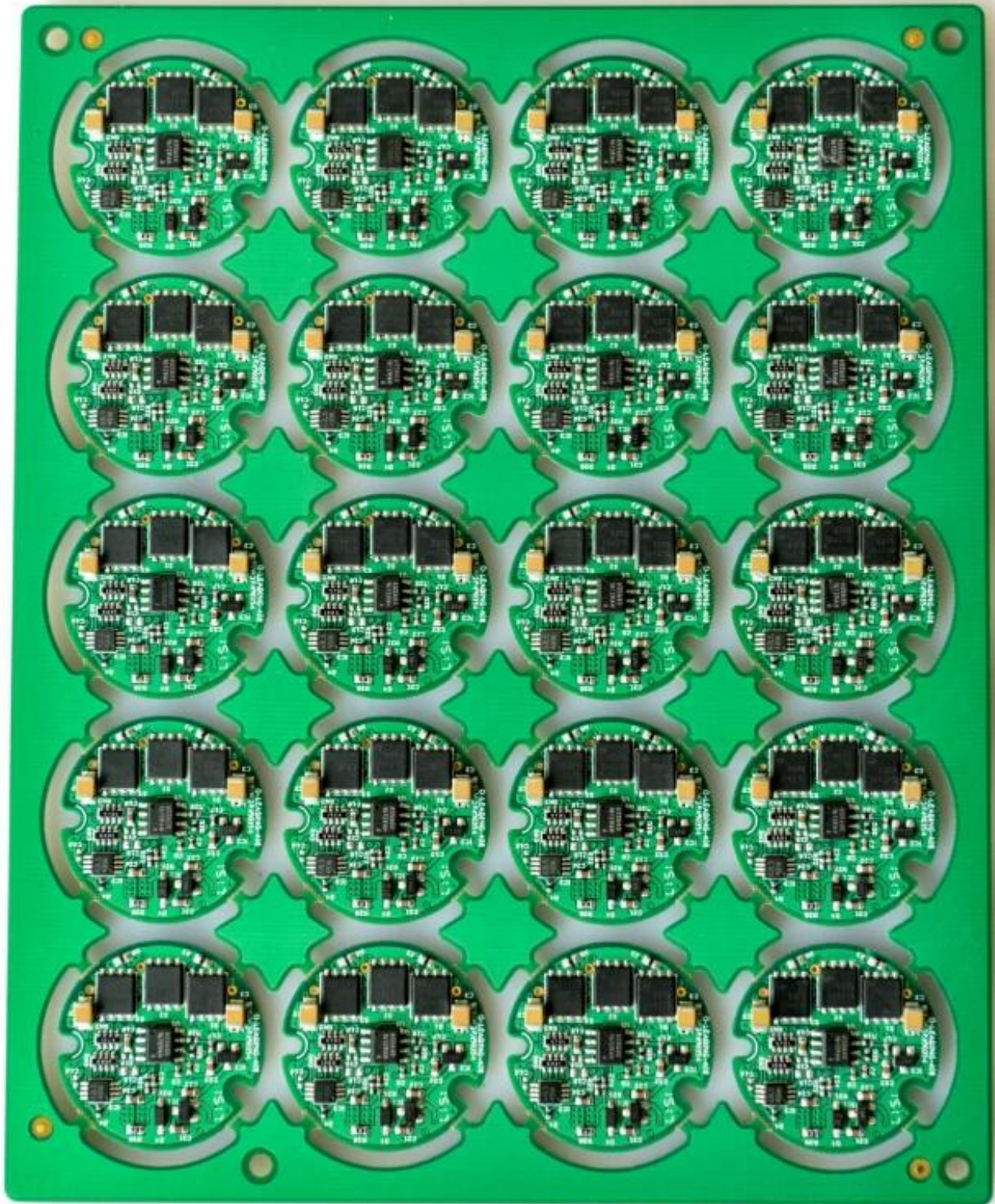
* .GBP - Pasta di saldatura inferiore

* .GCMB - Maschera di rivestimento conformale inferiore









[Fornitore di circuiti stampati, disegno del PCB in Cina](#)